

[KAIST IDEC] 시스템반도체설계 실무인력양성사업 컨소시엄 기업 추가 모집

■ 사업 개요

- 사업목표 : 시스템반도체 분야 산업경쟁력 강화를 위한 사업계 수요 기반의 교육 과정 개발 및 교육센터 운영을 통한 실무인력 양성
- 총 사업기간 : 2022.04.01~2028.12.31(6년 9개월)
- **3차년도 사업기간 : 2024.01.01~2024.12.31(12개월)**
- 주관수행기관 : KAIST 반도체설계교육센터(IDEC)
- 성과지표

성과지표		목 표							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	계
교육 수료	장기(미취업자)	20	180	180	180	180	180	180	1,100
인원 (명)	단기(재직자)	240	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	6,640

■ 컨소시엄 기업 협약

- 협약 기간 : 2024.04.01~2025.03.31 (1년 간)
- 기업 회원 등급별 의무 사항 및 혜택 사항

구분	골드(Gold) 회원사	실버(Silver) 회원사
의무사항	연회비 : 기업당 300만원/년 - 학생 채용시, 차년도 연회비에 학생 당 100만원씩 추가하여 납부 (6개월 이상 재직시 해당)	연회비 : 기업당 100만원/년 - 학생 채용시, 차년도 연회비에 학생 당 100만원씩 추가하여 납부 (6개월 이상 재직시 해당)
혜택사항	1. 수강생 우선 채용 기회 부여 2. 교육 커리큘럼 기획시 참여 3. 교육과정 중 회사 소개 기회 부여 4. 채용 연계 프로그램(Job Fair) 참여 5. 수강생 선발시 기업 추천 인재를 우선 선발 (해당 기업 재직자에 한함) 6. 수강생 선발시 심사위원으로 참여	1. 교육과정 중 회사 소개 기회 부여 2. 수강생 선발시 기업 추천 인재를 우선 선발 (해당 기업 재직자에 한함)

- 사업 소개 및 2024년 컨소시엄 기업 참여 현황 [바로가기](#)

■ 장기(4개월) 교육 운영

- 교육대상 : 반도체 분야 취업을 희망하는 전공, 비전공의 학부 졸업(예정자), 컨소시엄 기업 추천자 등
- 교육참가비 : 무료 (교육지원금, 중식, 교재 무료 제공)
- 협약 기간 내 교육기간 및 교육 내용
 - 제5기 : 2024.01~2024.04(4개월) / 아날로그(칩설계) 트랙, 디지털(칩설계) 트랙
 - 제6기 : 2024.05~2024.08(4개월) / 디지털(칩설계) 트랙, 디지털(FPGA) 트랙
 - 제7기 : 2024.09~2024.12(4개월) / 아날로그 트랙, 디지털 트랙
 - 제8기 : 2025.01~2025.04(4개월) / 아날로그 트랙, 디지털 트랙

**제7기 이후 교육 세부 주제는 추후 결정 예정*
- 교육 과정

구분	총 16주 과정				
	O/T	기초+심화 과정		실습과정	취업 연계
아날로그	1일	기초과목(6주)	심화과목(6주)	응용실습(4주)	2일
디지털		기초과목(8주)	심화과목(4주)		

■ 제6기 수강생 모집

- 신청기간 : 2024.02.26~03.08 (3주간)
- 모집정원 : 80명
- 신청인원 : 신청 준비중 (평균 경쟁률 4:1)
- 선발전형 : 서류 및 면접평가를 통해 최종 선발
- (참고 1) 제6기 홍보 포스터


산업통신자일부

KAIST IDEC

시스템반도체설계실무인력양성 교육

6기 교육생 모집



반도체설계교육센터(IDECE)는 KAIST 내 반도체설계 전문 교육센터로, 시스템반도체 분야에 실무 인력을 양성하기 위한 장기 교육을 운영하고 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.



2024.05.10(금) ~ 08.23(금) (4개월)

KAIST IDEC 통합교육장 (롯데백화점 동탄점 11)

신청 기간

2024.02.26(월) ~ 2024.03.08(금)

교육 과정

- 디자입 트랙 (참석자 특화)
- 디자입 트랙 (FPGA 특화)

교육 대상

반도체 분야 취업을 희망하는 전공 비전공 학부 졸업(예정)자

승강 혜택

 - ▶ 교육비 전액 지원
 - ▶ 교육지원금 지급 (소문 11)
 - ▶ 학력 기업 소문 및 취업 지원 제공

전환 일정

1 시범 전형 참가자 발표	2 면접 전형	3 최종 합격자 발표
3월 4주	4월 1주	4월 2주

신청 방법

온라인 (홈페이지 : academy.idec.or.kr)
또는 전화 (교육 실용 02-7802)를 확인해주시기 바랍니다.

문의

☑ wichae@kaist.ac.kr
☎ 031-8036-2463



교육 신청



신청기관



협력기관



한국정보보호진흥원



강사직


























홈페이지 바로가기

■ 컨소시엄 기업 신청 방법

- 신청기간 : **2024.02.21(수)~2024.03.12(화)**
- 신청방법 : 아래 담당자에게 참여희망 메일 발송
김영지 선임, 031-8036-2466, yeongji@kaist.ac.kr

· (참고 2-대외비) 제5기 최종 합격자 명단(2024.02.13기준)

제 5 기 교육생 리스트 - 디지털 트랙				
No.	성명	생년	대학교	학과
1	강**	1999	강원대학교	전자공학과
2	김**	1999	한국항공대학교	전자및 항공전자공학
3	김**	1998	광운대학교	전자공학과
4	김**	1998	광운대학교	전자공학과
5	김**	1999	송실대학교	전자정보공학부 전자공학전공
6	김**	1998	세종대학교	전자정보통신공학과
7	김**	1997	송실대학교	전자정보공학부
8	나**	1999	경북대학교	전자공학부
9	노**	2000	한국항공대학교	전자 및 항공전자공학
10	노**	1998	경희대학교	전자공학과
11	문**	1997	홍익대학교	전자전기공학부
12	문**	1998	명지대학교	전자공학과
13	박**	1997	건국대학교	전기전자공학부
14	박**	1998	한국외국어대학교	전자공학과
15	박**	1998	한밭대학교	전자제어공학과
16	박**	1998	서경대학교	전자공학과
17	서**	2000	세종대학교	전자정보통신공학과
18	손**	1999	이화여자대학교	전자전기공학과
19	송**	1999	한국기술교육대학교	전자공학과
20	송**	1999	경희대학교	전자공학과
21	안**	1997	경희대학교	전자공학과
22	양**	1999	전북대학교	전자공학부(나노전자)
23	오**	1999	명지대학교	전자공학과
24	이**	1998	경희대학교	전자공학과
25	이**	1999	경북대학교	전자공학부
26	이**	1997	금오공과대학교	전자공학부 반도체시스템전공
27	이**	1999	전북대학교	전자공학부(나노전자전공)
28	이**	1998	홍익대학교	전자전기
29	이**	1999	한양대학교 ERICA	전자공학부
30	장**	1999	경희대학교	전자공학과
31	장**	1996	단국대학교	전기전자공학과
32	정**	1999	성균관대학교	전자전기공학부
33	최**A	1999	국립목포대학교	정보통신공학과
34	최**B	1996	한국항공대학교	전자및항공전자공학
35	최**	2001	건국대학교	전기전자공학부
36	최**	1997	홍익대학교	전자전기공학부

제 5 기 교육생 리스트 - 아날로그 트랙

No.	성명	생년	대학교	학과
1	강**	2000	서울과학기술대학교	MSDE 학과
2	강**	1999	충북대학교	전자공학부
3	공**	1999	가톨릭대학교	정보통신전자공학부
4	김**	1999	성균관대학교	전자전기공학부
5	김**	1998	고려대학교	전기전자공학부
6	김**	2000	조선대학교	전자공학과
7	김**	1998	송실대학교	전자정보공학부 IT 융합학과
8	김**	2000	중앙대학교	전자전기공학부
9	김**	1999	충북대학교	전자공학부
10	김**	1998	홍익대학교	전자전기공학부
11	김**	2001	송실대학교	전자정보공학부(전자공학전공)
12	나**	1999	조선대학교	전자공학과
13	도**	1999	계명대학교	전자공학과
14	류**	1999	경북대학교	전자공학부
15	민**	1999	서경대학교	전자공학과
16	박**	1999	경성대학교	전자공학과, 산업경영공학과
17	박**	1997	한밭대학교	창의융합학과
18	배**	1998	대구대학교	전자전기공학부 전자공학전공
19	성**	1998	한국항공대학교	전자 및 항공전자공학
20	신**	1999	강원대학교	전자공학과
21	심**	1998	단국대학교	전자전기공학부
22	안**	1998	송실대학교	전자정보공학부 전자공학전공
23	양**	2001	건국대학교	전기전자공학부
24	오**	2001	건국대학교	전기전자공학부
25	유**	1998	홍익대학교	전자전기공학부
26	이**	1999	성균관대학교	전자전기공학부
27	이**	1998	홍익대학교	전자전기공학부
28	이**	1998	광운대학교	전자공학과
29	이**	1999	한국외국어대학교	전자공학과
30	이**	1999	경희대학교	정보디스플레이학과
31	이**	2000	한국기술교육대학교	전기공학과
32	이**	1998	건국대학교(서울)	전기전자공학부
33	이**	1994	인하대학교	전자공학과
34	임**	1998	홍익대학교	전자전기공학부
35	전**	1999	고려대학교(세종)	전자및정보공학
36	정**	1998	홍익대학교	전자전기공학부
37	최**	2001	경희대학교	전자공학과
38	최**	1999	남서울대학교	전자공학과

- (참고 3) 협약서 양식

시스템반도체설계 실무인력양성 협약서

반도체설계교육센터와 회사명(예:㈜코리아반도체)(이하 “양 기관”이라 한다)는 상호 포괄적 협력을 효율적으로 추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 양 기관이 시스템반도체 분야 산업 경쟁력 강화를 위한 산업계 맞춤형 설계 실무인력양성을 목적으로 한다.

제2조(협약사항) 반도체설계교육센터는 시스템반도체설계 실무인력양성 교육 과정을 성실히 수행하고, **회사명(예:(주)코리아반도체)**는 다음 각 호의 사항에 대해 적극 협력하고 지원한다.

1. 혜택사항

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1) 수강생 우선 채용 기회 | 4) 채용 연계 프로그램 참여 |
| 2) 교육 처리관련 기획 시 참여 | 5) 기업 추천 인재 우선 선발 |
| 3) 교육과정 중 회사 소개 | 6) 수강생 선발 시 심사위원으로 참여 |

2. 의무사항

- 1) 교육과정 지원비 300만원/년 납부
 - 학생 채용 시, 차년도 교육과정 지원비에 학생당 100만원씩 추가 납부
(8개월 이상 재직 시 해당)

제3조(협약이행) 양 기관은 제2조의 협력사항을 이행하기 위하여 인적·물적 자원의 제공 및 자문 등의 방법으로 상호 교류 협력하며 구체적인 시행사항은 상호 협의하에 따로 정할 수 있다.

제4조(협약기간) 본 협약의 기간은 2023.09.01~2024.08.31(1년)이며, 양 기관이 효력 정지를 요청하지 않는 경우 자동으로 1년 단위로 연장된다.

이 협약의 체결을 증명하기 위하여 각 기관이 서명한 후 각 1부씩 보관한다.

2024년 0월 00일

반도체설계교육센터
소 장 박 인 권

회사명(예:㈜코리아반도체)
대표자 직위 및 성명(예:대표이사 000)

(대표이사 서명)